

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載  
【部門区分】第7部門第2区分  
【発行日】平成18年2月23日(2006.2.23)

【公開番号】特開2000-82840(P2000-82840A)  
【公開日】平成12年3月21日(2000.3.21)  
【出願番号】特願平11-72005

## 【国際特許分類】

<b>H 0 1 L</b>	<b>31/16</b>	<b>(2006.01)</b>
<b>G 0 1 C</b>	<b>3/06</b>	<b>(2006.01)</b>
<b>G 0 2 B</b>	<b>7/32</b>	<b>(2006.01)</b>
<b>G 0 3 B</b>	<b>13/36</b>	<b>(2006.01)</b>

## 【F I】

H 0 1 L	31/16	B
G 0 1 C	3/06	A
G 0 2 B	7/11	B
G 0 3 B	3/00	A

【手続補正書】  
【提出日】平成18年1月10日(2006.1.10)  
【手続補正1】  
【補正対象書類名】明細書  
【補正対象項目名】0006  
【補正方法】変更  
【補正の内容】

## 【0006】

## 【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、この構造ではチップの面積が大きくなると共に、PSDと2分割PDの分離部に光を照射するため、信号光の一部分しか位置検出に用いることができず、照射する信号光のスポット径が小さいときには検出感度を向上させることができない。本発明はこのような課題に鑑みてなされたものであり、従来技術に比して小型であって、検出感度を向上可能な半導体位置検出器を提供することを目的とする。